

層數 : 2
基材 : FR4
銅厚 : 1.57mm +/- 10 %
銅厚 : 1oz
表面處理 : ENIG (Au : 2-5u ")
阻焊 (銅) : 藍, LPI (銅)
阻焊 (銅) : 藍, 白

其他規格

規格 : 符合 IPC-6012 符合 IMMING GOLD PLATED 規格。
鍍層 .050uM 3-6uM NICKEL 鍍層。

銅厚公差 銅厚 .025 AVG, .020 MIN .. 銅厚公差 .500 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差。

其他規格 :

=====

*.GM4 : 銅厚 銅厚

*.TXT : NC 銅厚 銅厚

*.GTP : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GTO : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GTS : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GTL : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GBL : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GBS : Bottom Soldermask

*.GBO : 銅厚 銅厚 銅厚

*.GBP : 銅厚 銅厚 銅厚





